

通富微电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

|               |  |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别     | <div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访</div> <div><input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）</div>   |
| 参与单位名称及人员姓名   | 鹏扬基金：章宏帆；泰康资产：余思雨；申万菱信：徐巡；拾贝投资：王祥宇；鑫元基金：施欣彤；南方基金：葛树名、金岚枫；兴银基金：阮姝漫；道仁资产：李晓光；汇丰晋信：刘昱辰；汇添富：钱晨润；长江证券：钟智铎；丹羿投资：朱亮   |
| 时间            | 2026 年 1 月 16 日  |
| 地点            | 公司会议室  |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书 蒋澍   |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <div>一、公司概况</div> <p>通富微电是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司大股东为南通华达微电子集团股份有限公司，实际控制人为石明达先生，股权结构稳定。</p> <p>公司先后在江苏南通崇川、南通苏通科技产业园、安徽合肥、福建厦门、南通市北高新区建厂布局；通过收购 AMD 苏州及 AMD 槟城各 85%股权，在江苏苏州、马来西亚槟城拥有生产基地。2024 年，公司与相关方签订《股权买卖协议》，以自有资金收购京隆科技 26%股权，京隆科技运营模式和财务状况良好，其在高端集成电路专业测试领域具备差异化竞争优势。公司已于 2025 年 2 月 13 日完成交割并支付了相关股权购买价款，公司收购京隆科技部分股权可提高公司投资收益，为公司带来稳定的财务回报，为全体股东创造更多价值。</p> |

公司总部位于江苏南通，拥有全球化的制造和服务网络，在南通、合肥、厦门、苏州、马来西亚槟城布局九大生产基地，实现了高效率和高质量的生产能力，为全球客户提供快速和便捷的服务，在全球拥有超两万名员工。公司与客户紧密合作，致力于成为国际级集成电路封测企业，通过技术创新、市场拓展和产能提升等措施，不断提升公司的核心竞争力和市场地位。同时，公司也将积极响应国家产业政策导向，依托国家产业基金的支持，抓住集成电路产业快速发展的历史机遇，为推动我国集成电路产业的进步和发展做出贡献。

财务数据方面，公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度分别实现营收 214.29 亿元、222.69 亿元、238.82 亿元和 201.16 亿元。公司 2022 年、2023 年、2024 年和 2025 年前三季度的归母净利润分别为 5.02 亿元、1.69 亿元、6.78 亿元和 8.60 亿元。

**二、投资者关注的主要问题**

**问题 1：简单介绍一下公司的业务情况及应用领域？**

回复：公司是集成电路封装测试服务提供商，为全球客户提供从设计仿真到封装测试的一站式服务。公司的产品、技术、服务全方位覆盖了人工智能、高性能计算、大数据存储、显示驱动、5G 等网络通讯、信息终端、消费终端、物联网、汽车电子、工业控制等多个领域，满足了客户的多样化需求。公司紧紧抓住市场发展机遇，面向未来高附加值产品以及市场热点方向，立足长远，大力开发扇出型、圆片级、倒装焊等封装技术并扩充其产能；此外，积极布局 Chiplet、2D+等顶尖封装技术，形成了差异化竞争优势。

**问题 2：简单介绍一下本次向特定对象发行股票的募集资金用途投向？**

回复：本次募集资金总额不超过 44 亿元，扣除发行费用后将全部用于五大方向：存储芯片封测产能提升项目（拟投 8 亿元）、汽车等新兴应用领域封测产能提升项目（拟投 10.55 亿元）、晶圆级封测产能提升项目（拟投 6.95 亿元）、高性能计算及通信领域封测产能提升项目（拟投 6.2 亿元），以及补充流动资金及偿还银行贷款（拟投 12.3 亿元）。

**问题 3：本次发行的股票数量上限是多少？有单个投资者的**

**认购限制吗？**

回复：本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即本次发行不超过 455,279,073 股（含本数）。其中单个认购对象及其关联方、一致行动人认购数量合计不得超过 151,759,691 股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的 10%。若单个认购对象及其关联方、一致行动人在本次发行前已经持有公司股份的，则其在本次发行后合计持股不得超过 151,759,691 股（含本数），超过部分的认购为无效认购。

**问题 4：公司本次发行“存储芯片封测产能提升项目”具体的项目计划是什么？**

回复：本项目计划投资 88,837.47 万元提升存储芯片封测产能，项目建成后年新增存储芯片封测产能 84.96 万片。本项目实施将有助于公司进一步扩大生产规模、优化产品结构、增强抗风险能力，巩固并增强公司在存储封测领域的优势地位。

**问题 5：本次发行中的四个主要募投项目均为产能提升项目，请分析一下其必要性？**

回复：公司基于对半导体产业趋势的洞察与自身产能版图的评估，持续提升和优化自身封测产能，选择具备战略价值、市场前景度高、符合技术演进方向、确定性强的项目作为资本投入及产能升级的主轴，为境内外客户提供专业可靠的封测解决方案，巩固公司在产业链中的核心支撑作用。

在必要性方面，下游人工智能、新能源汽车、移动智能终端、物联网等领域的技术变革与升级，叠加半导体领域国产替代的持续推进，正持续催生对相关芯片的大规模封测需求。公司产线整体保持较高产能利用率，产能瓶颈逐步显现。本次募投项目以现有产业化封测平台为基础实施产能提升，针对上述行业发展趋势，重点围绕存储芯片封测、车载芯片封测、晶圆级封测以及面向高性能计算与通信芯片的封测能力进行布局，在扩充产能规模的同时优化产品与工艺结构，提升公司面向高端化产品的封测实力。本次募投项目匹配下游芯片高算力、高可靠性、高集成度的发展趋势，有助于公司在“技术变革”与“国产替代”浪潮叠加背景下把握市场发展机遇，更好满足下游客户需求，支持后摩尔时代芯片性能的持续跃升。

|          |  |
|----------|--|
|          | <p><b>问题 6：本次发行后对公司业务结构有什么影响？</b></p> <p>回复：本次发行完成后，募集资金将用于公司主营业务以及补充流动资金和偿还银行贷款，公司业务结构不会发生重大变化。本次募集资金拟投入项目将进一步夯实公司现有主营业务，优化公司产能结构布局，增强公司的市场竞争力，从而提升公司的盈利能力。</p> <p><b>问题 7：公司近期存不存在涨价的情况？</b></p> <p>回复：公司具备较完善的产品价格管理体系，会综合考虑市场供需、生产成本、原材料价格等多方面因素来进行价格调整，最终由公司与客户根据市场化原则，协商确定封测价格。谢谢！</p> |
| 附件清单(如有) | 无  |
| 日期       | 2026 年 1 月 16 日  |